

债券简称：22 金桥 G1/22 金桥债 01

债券代码：184422.SH/2280250.IB

债券简称：22 金桥 G2/22 金桥债 02

债券代码：184580.SH/2280412.IB

## 海通证券股份有限公司

关于上海金桥（集团）有限公司涉及新增借款

的临时债权代理事务报告

债权代理人



海通证券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二四年十二月

## 重要声明

本报告依据《2022 年上海金桥（集团）有限公司公司债券  
债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定和约  
定、公开信息披露文件以及上海金桥（集团）有限公司（以下简  
称公司、金桥集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相  
关资料等，由债权人海通证券股份有限公司（以下简称海通  
证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，  
投资者应对相关事宜做出独立判断。

## 一、新增借款事项

根据发行人 2024 年 12 月 10 日披露的《上海金桥（集团）有限公司关于新增借款的公告》（以下简称公告），发行人披露了关于单笔新增借款超过 2023 年末净资产 20% 的情形，具体情况如下：

### （一）新增借款概述

截至 2024 年 11 月 30 日，发行人发生单笔新增借款超过 2023 年末净资产 20% 的情形。

单位：亿元

序号	借款主体	借款金额	担保措施
1	上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司	56.00	抵押保证担保

### （二）借款协议情况

上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司成立于 2002 年 5 月 16 日，为发行人 100% 控股子公司，注册资本为人民币 296,803.58 万元，公司法定代表人为周尧。截至 2023 年末，上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司资产规模为 50.89 亿元，净资产为 28.37 亿元，2023 年度实现营业总收入 0.75 亿元，实现净利润-0.05 亿元。

上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司与国家开发银行上海市分行签署《人民币资金借款合同》，合同总金额为人民币 56.00 亿元，借款用途为用于金谷智能终端制造基地 WK14-4

地块项目建设，借款期限为 25 年，为抵押保证担保。

截至 2024 年 11 月 30 日，上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司已累计提款上述借款 0.91 亿元。

### （三）相关决策情况

上述借款已经过公司内部决策程序审批通过，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

## 二、影响分析和应对措施

因发行人日常经营和业务发展需要，2024 年度增加银行借款融资，上述新增借款主要用于金谷智能终端制造基地 WK14-4 地块项目建设。截至发行人公告出具日，发行人各项业务经营情况正常。上述借款预计不会对发行人的日常经营、偿债能力产生重大不利影响。后续，发行人将持续关注自身新增借款情况，合理规划筹资安排，并及时履行信息披露义务。

海通证券作为“22 金桥 G1/22 金桥债 01”及“22 金桥 G2/22 金桥债 02”债券债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关规定和约定出具本债权代理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照

《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海金桥(集团)有限公司涉及新增借款的临时债权代理事务报告》之盖章页)



海通证券股份有限公司

2024年12月17日